

橋梁の3D化に向けた、ドローンとスマートフォンによる計測を行いました！！



日本大学工学部とのタイアッププロジェクトの一環として、5月17日（水）～18日（木）にかけて、東京大学大学院工学系研究科 全邦釘特任准教授の研究室と共に、平田村が管理する橋梁の3Dモデルを製作するためにドローンとスマートフォンを用いた計測を行いました。

橋梁の3Dモデルにより、3Dモデル上の位置と損傷画像を紐づけたり、寸法の計測をモデル上で行うことができる等、維持管理の効率化が期待されます。